

## HSG20X

ワーク加工サイズ：～φ200mm

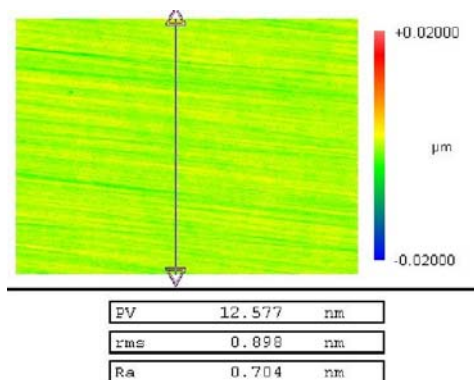
### 単結晶基板 (SiC, GaN, LN 等) の 鏡面加工を高効率で実現 (Ra=1nm 以下)

#### 単結晶SiCの加工事例 (φ4インチ基板)

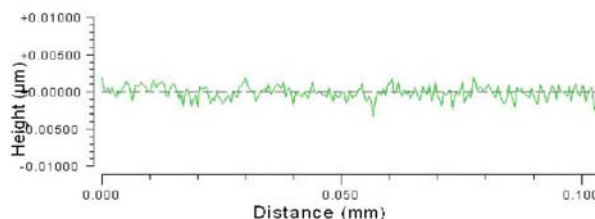
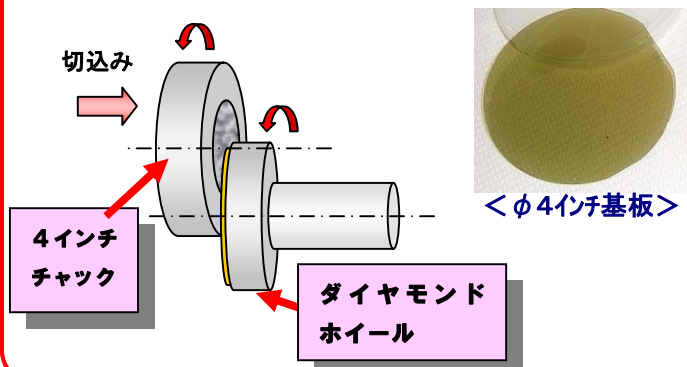
##### 高効率で高精度な平面研削を実現

- (1) 従来ラップでしか出来なかった鏡面加工 (Ra=1nm 以下) を研削で実現
- (2) 当社平面研削盤の採用で平坦化のラップ工程を省略可能  
加工時間がラップ加工の 1/30 に (当社調査より)

##### <加工結果> Ra=0.7nm



##### <平面研削の加工イメージ>



注) 本加工事例は、当社試験機による結果です

#### HSG20Xの特徴



横型平面研削盤 HSG-20X 外観図

##### <高剛性と高精度の両立を実現した独自の機械構造>

- (1) 機械要素の最適配置で高いループ剛性を実現
- (2) 空気と油の静圧スピンドルを使い分けた最適配置で小型化を実現
- (3) 油静圧スライドの採用で滑らかで高精度な砥石送りを実現

##### <砥石メーカーとの

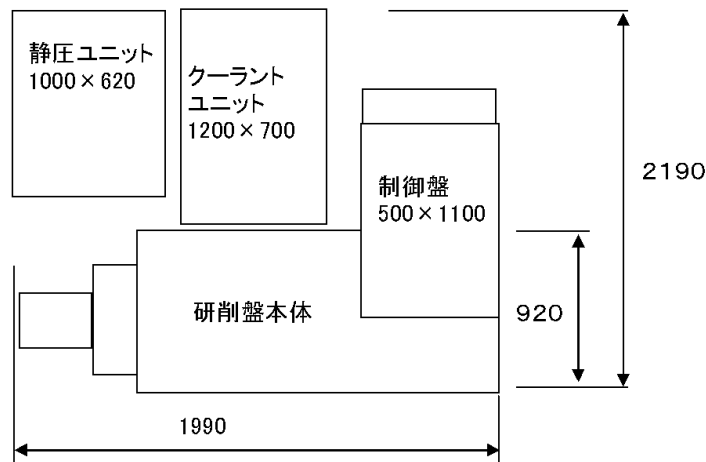
アライアンスにより最適加工提案>

- (1) 機械の能力を最大限に活かす最適な砥石の提案が可能

《主な仕様》

項目		仕様	単位	備考
加工ワーク	加工ウェハ寸法または治具寸法	Max φ200	mm	φ50、φ100、φ150 ほか各種サイズ対応可(オプション)
使用砥石	砥石外径寸法	φ200	mm	カップ型ダイヤモンドホイール
砥石スピンドル	砥石スピンドル回転数	~1,500	rpm	AC サーボモータ駆動
ワークスピンドル	ワークテーブル最高回転数	~500	rpm	AC サーボモータ駆動
	ワークチャック方式	真空チャック		セラミックポラスチャック マグネットチャック(オプション)
ワークチャック切り込み軸	ストローク	~100	mm	位置設定単位=0.01 μm
	スライド方式	静圧スライド		
	移動速度	0.001~500	mm/min	
ワーク厚み測定装置	分解能	0.1	μm	インプロセス測定、接触式対応可(オプション)
大きさ質量	機械本体サイズ	1990 W x 920 D x 1425 H	mm	制御盤を除く
	本体質量	4,400	Kg	制御盤を除く

(配置図)



注) 本仕様は、製品改良のため、おことわりなしに変更する場合があります。

上記、外形/寸法には、メンテナンススペースが含まれておりません。

**NACHI**  
株式会社 不二越

本商品の技術的なお問い合わせは  
 (株)ナチマシンリーエンジニアリング 開発技術部 TEL(076)456-2585 FAX(076)492-3144  
 富山県富山市不二越本町 1-1-1 〒930-0965  
 E-Mail nanotech@nachi-fujikoshi.co.jp

ホームページ <http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/>

東京本社 TEL(03)5568-5111 FAX(03)5568-5292 〒105-0021 東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 17F  
 富山本社 TEL(076)423-5111 FAX(076)493-5211 〒930-8511 富山市不二越本町 1-1-1

DOCUMENT No. PPF0083A

2014.12